

2025-2031年中国半导体硅 片行业“专精特新”市场深度评估与投资方向研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国半导体硅片行业“专精特新”市场深度评估与投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202502/478413.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2025-2031年中国半导体硅片行业“专精特新”市场深度评估与投资方向研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展概述

1.1 半导体硅片行业的界定

1.1.1 半导体硅片概念界定

1.1.2 半导体硅片所处产业链环节

1.1.3 半导体硅片产品分类

1.1.4 半导体硅片所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

(1) 专精特新“小巨人”

(2) 专精特新中小企业

(3) 其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

(1) 中国中小企业发展现状

(2) 中国制造业发展现状

(3) 服务“国内国际双循环”发展格局

1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析

(1) 全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡

(2) 中国高科技发展遭遇“卡脖子”

1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国半导体硅片行业发展现状分析

2.1 全球半导体硅片行业发展现状

2.1.1 全球半导体硅片行业发展规模

2.1.2 全球半导体硅片行业区域发展格局

2.1.3 全球半导体硅片行业企业竞争格局

2.2 中国半导体硅片行业发展现状

2.2.1 中国半导体硅片行业发展规模

2.2.2 中国半导体硅片行业区域发展格局

2.2.3 中国半导体硅片行业企业竞争格局

2.3 中国半导体硅片行业技术水平及国产化现状

2.3.1 中国半导体硅片行业技术发展现状

(1) 半导体硅片行业技术创新现状

(2) 半导体硅片行业专利申请情况

(3) 半导体硅片行业技术研发趋势

2.3.2 中国半导体硅片行业国产化发展现状

(1) 半导体硅片行业国产化率分析

(2) 半导体硅片行业本土企业布局

2.4 中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析

第3章：中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

3.1 中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析

3.1.1 国家层面半导体硅片行业发展相关政策及规划汇总解读

(1) 半导体硅片行业发展相关政策汇总

(2) 半导体硅片行业发展相关规划汇总

3.1.2 国家层面半导体硅片行业“专精特新”相关政策汇总解读

3.1.3 国家“十四五”规划对半导体硅片行业发展的影响分析

3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对半导体硅片行业的影响分析

3.1.5 半导体硅片行业“专精特新”发展的政策机遇分析

3.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投融资环境分析

3.2.1 中国半导体硅片行业“专精特新”领域主要资金来源

3.2.2 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资主体

- 3.2.3 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资方式
- 3.2.4 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资事件汇总
- 3.2.5 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资机遇分析
 - (1) 半导体硅片行业“专精特新”财税扶持力度
 - (2) 半导体硅片行业“专精特新”信贷支持政策
 - (3) 半导体硅片行业“专精特新”市场化融资渠道
 - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
- 3.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展战略支撑及保障

第4章：中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

- 4.1 中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案解读
 - 4.1.1 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育目的
 - 4.1.2 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育对象
 - 4.1.3 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育内容
 - 4.1.4 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育措施
 - 4.1.5 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业奖励标准
- 4.2 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读
 - 4.2.1 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件
 - 4.2.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件
 - 4.2.3 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件
 - 4.2.4 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读
- 4.3 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析
 - 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征
 - (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布
 - 4.3.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育特征

第5章：中国半导体硅片产业链全景梳理及“专精特新”重点领域汇总

- 5.1 中国半导体硅片产业结构属性（产业链）分析

- 5.1.1 中国半导体硅片产业链结构梳理
- 5.1.2 中国半导体硅片产业链生态图谱
- 5.2 中国半导体硅片产业价值属性（价值链）分析
- 5.2.1 中国半导体硅片行业成本结构分析
- 5.2.2 中国半导体硅片行业价值链分析
- 5.3 中国半导体硅片产业链发展痛点分析
- 5.4 中国半导体硅片产业链“专精特新”鼓励布局方向

第6章：中国半导体硅片产业链环节“专精特新”布局状况研究

- 6.1 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”布局状况研究
 - 6.1.1 中国半导体硅片产业生产设备市场发展现状
 - (1) 生产设备-晶体生长炉市场发展现状
 - (2) 生产设备-单晶硅截断机市场发展现状
 - (3) 生产设备-单晶棒滚磨机市场发展现状
 - 6.1.2 中国半导体硅片产业生产设备市场发展痛点分析
 - 6.1.3 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”市场培育现状
 - 6.1.4 中国半导体硅片产业生产设备市场竞争格局分析
 - 6.1.5 中国半导体硅片产业生产设备市场前景及趋势
- 6.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”布局状况研究
 - 6.2.1 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展现状分析
 - (1) 8寸（200mm）及以下单晶硅片市场发展规模
 - (2) 8寸（200mm）及以下单晶硅片技术发展现状
 - (3) 8寸（200mm）及以下单晶硅片国产化发展现状
 - 6.2.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析
 - 6.2.3 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”市场培育现状
 - 6.2.4 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片市场竞争格局分析
 - 6.2.5 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展前景及趋势
- 6.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片“专精特新”布局状况研究
 - 6.3.1 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展现状分析

- (1) 12寸（300MM）单晶硅片市场发展规模
- (2) 12寸（300MM）单晶硅片技术发展现状
- (3) 12寸（300MM）单晶硅片国产化发展现状
- 6.3.2 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展痛点分析
- 6.3.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片“专精特新”市场培育现状
- 6.3.4 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片市场竞争格局分析
- 6.3.5 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展前景及趋势
- 6.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片“专精特新”布局状况研究
- 6.4.1 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展现状分析
 - (1) 18寸（450mm）单晶硅片市场发展规模
 - (2) 18寸（450mm）单晶硅片技术发展现状
 - (3) 18寸（450mm）单晶硅片国产化发展现状
- 6.4.2 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展痛点分析
- 6.4.3 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片“专精特新”市场培育现状
- 6.4.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片市场竞争格局分析
- 6.4.5 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展前景及趋势

第7章：中国半导体硅片行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

- 7.1 中国半导体硅片产业资源区域分布状况
- 7.2 中国半导体硅片行业企业数量区域分布
- 7.3 中国半导体硅片行业区域发展格局分析
- 7.4 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析
- 7.5 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及申报条件
 - 7.5.1 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业培育方案解读
 - (1) 省级“专精特新”企业培育方案解读
 - (2) 市级“专精特新”企业培育方案解读
 - 7.5.2 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业奖励标准
 - 7.5.3 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报条件解读
 - (1) 省级“专精特新”企业申报条件

- (2) 市级“专精特新”企业申报条件
- 7.5.4 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报流程解读
 - (1) 省级“专精特新”企业申报流程
 - (2) 市级“专精特新”企业申报流程
- 7.6 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”市场培育现状

第8章：中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比及案例研究

- 8.1 中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比
- 8.2 中国半导体硅片行业代表性“小巨人”企业布局案例研究
 - 8.2.1 企业一

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.2 企业二

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.3 企业三

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.4 企业四

- (1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.5 企业五

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.6 企业六

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.7 企业七

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.8 企业八

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.9 企业九

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

(4) 企业半导体硅片产业链布局状况

(5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.10 企业十

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

(4) 企业半导体硅片产业链布局状况

(5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

第9章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国半导体硅片行业市场前景预测

9.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判

9.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展前景预测

第10章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

10.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性分析

10.1.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资壁垒分析

10.1.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资风险预警及防范

10.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资价值评估

10.3 中国半导体硅片行业“专精特新”投资机会分析

10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

10.3.2 区域市场投资机会

10.3.3 细分市场投资机会

10.4 中国集成电路设计行业“专精特新”潜在发展方向分析

第11章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略及发展建议

11.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略

11.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展建议

图表目录

图表1：中国半导体硅片行业本土企业布局情况

图表2：中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析

图表3：截至2024年中国半导体硅片行业发展政策汇总-国家层面

图表4：截至2024年中国半导体硅片行业发展规划汇总-国家层面

图表5：截至2024年中国半导体硅片行业“专精特新”发展政策解读-国家层面

图表6：中国半导体硅片产业链发展痛点分析

图表7：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片本土企行业布局情况

图表8：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析

图表9：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片本土企行业布局情况

图表10：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展痛点分析

图表11：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片本土企行业布局情况

图表12：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展痛点分析

图表13：企业一发展历程

图表14：企业一基本信息表

图表15：企业一股权穿透图

图表16：企业一经营状况

图表17：企业一整体业务架构

图表18：企业一销售网络布局

图表19：企业一半导体硅片业务布局优劣势分析

图表20：企业二发展历程

图表21：企业二基本信息表

图表22：企业二股权穿透图

图表23：企业二经营状况

图表24：企业二整体业务架构

图表25：企业二销售网络布局

图表26：企业二半导体硅片业务布局优劣势分析

图表27：企业三发展历程

图表28：企业三基本信息表

图表29：企业三股权穿透图

图表30：企业三经营状况

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202502/478413.html>